

通信インフラ

セットトレンド

- ・高速通信(~40Gbps)
- ・ポート、データ数増加
- ・薄型化(1U)

電源トレンド

- ・LSI負荷電流の増加

LSI大電流化&LSI数量増加
 <出力>
 ・FPGA/ASIC(1V/~70A)
 ・その他LSI(1V/~20A)

キャパシタ
要求仕様

低ESR

大容量

低背

推奨商品特長

SP-Cap

- ・超低ESR(3mΩ~)
- ・低背(1~2mm)

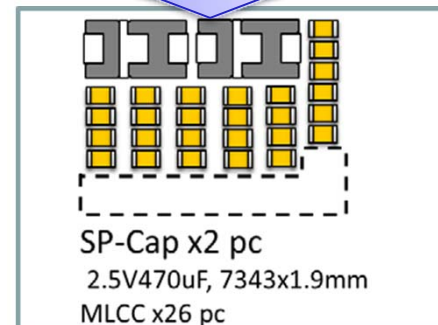
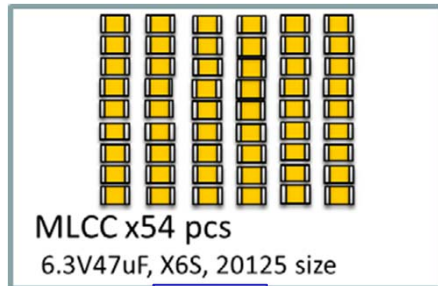


POSCAP

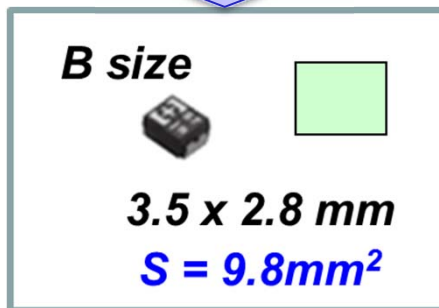
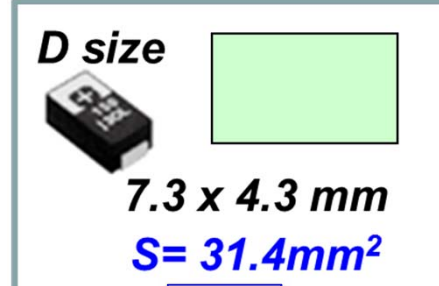
- ・低ESR(5mΩ~)
- ・小形化(3528)



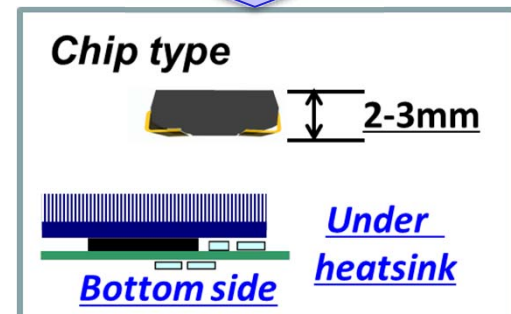
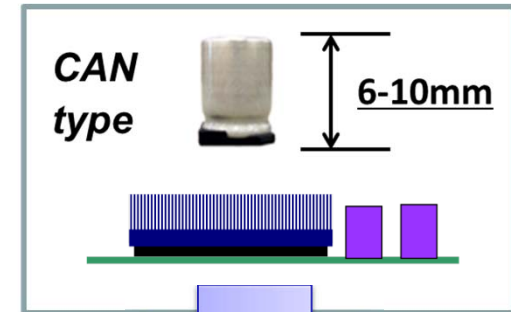
提案



➤コスト削減+スペース削減



➤コスト削減+スペース削減



➤スペース削減